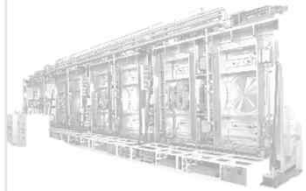
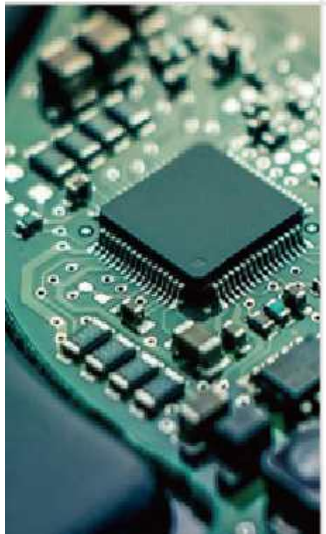


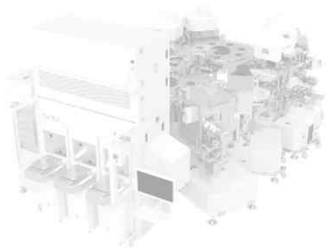
Advanced VAcuum & Clean equipment Optimizer

AVACO

Investor Relations 2026













AJACO | Advanced VAcuum & Clean equipment Optimizer

Disclaimer

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 주식회사 아바코 (이하 "회사") 에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려 드리는 바입니다. 본 Presentation에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 관련 증권거래법률에 대한 위반에 해당 될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 회사의 경영실적 및 재무성과와 관련된 모든 정보는 기업회계 기준에 따라 작성되었습니다. 본 자료에 포함된 "예측정보 " 는 별도 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다.
이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대(E)' 등과 같은 단어를 포함합니다.
위 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로
인하여 실제 미래실적은 "예측정보 " 에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것 이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.(과실 및 기타의 경우 포함) 본 문서는 주식의 모집 또는 매매를
위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.



Advanced VAcuum &
Clean equipment Optimizer



Chapter 01

Investment Highlights

01 산업 이슈 및 대응 전략

디스플레이
Display

글로벌 기업 투자 계획[1]

BOE
8.6세대 OLED 11조원 투자(~27년)

TCL
8.6세대 OLED 6조원 투자(~28년)

LG Display
8.6세대 OLED 1.1조원 투자(~28년)

HKC TRULY TIANMA
OLED 투자 기대

대규모 OLED 투자 재개는 진공 이송, 박막 형성 장비 수요로 연결

글로벌 패널 고객사 레퍼런스를 기반으로 후속 투자 사이클 대응

이차전지
Secondary battery

북미 지역 배터리 예상 생산규모[2]

(단위: 기가와트)



LG Energy Solution

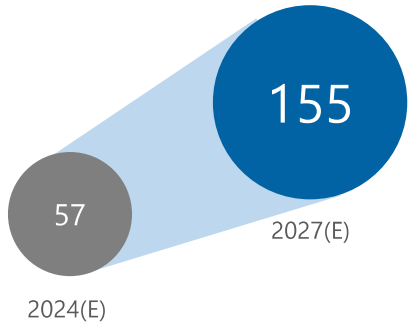
ESS, 각형 전환과 차세대 배터리 시장 개화에 따른 공정장비 수요 확대

전극·자동화 장비 기반에 건식전극, 전고체 대응 장비 개발 추진

반도체
Semiconductor & Packaging

세계 AI 반도체 매출 예상 추이[3]

(단위: 조 원)



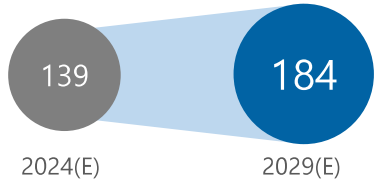
AI, HBM 확산으로 첨단 패키징, 유리기판 공정 수요 확대

Metal Sputter, TGV, PlasmaLine 기반 고부가 장비 시장 진입 추진

MLCC
Multi Layer Ceramic Capacitor

세계 MLCC 매출 예상 추이[4]

(단위: 억달러)



온디바이스 AI 시장 개화

+

전장용 MLCC 연평균 15% 성장 전망[4]

2023~2028(E)

아바텍 증설 및 고성능 MLCC 수요 확대에 따른 장비 공급 기회 부각

적층기 등 핵심 공정장비 기반으로 MLCC 사업 확장 추진

1) UBI Research, OMDIA, 보도내용 참고
2) Marklines, SNEResearch, 보도내용 참고
3) 한국반도체산업협회, 보도내용 참고
4) Global Information, 보도내용 참고

02 핵심 성장 축

첨단 산업을 아우르는 성장 포트폴리오 구축

Display

디스플레이 · OLED · 글로벌 장비 공급 확대

Market OLED 투자 재개 · 글로벌 패널 고객사 증설

Key Equipment OLED In-line Vacuum · Sputtering · 증착 자동화

Growth Focus 주요 고객사 공급확대 · 글로벌 고객 기반 강화

Battery

이차전지 · 공정 전환 · 차세대 전극 · 신규 장비시장 선점

Market ESS 투자 · 각형 배터리 채택 확대 · 차세대 전극 상용화

Key Equipment Roll Press · Slitter · 자동화 · 건식전극 · 리튬메탈

Growth Focus 차세대 전극 장비 사업화 · AI 적용 자동화 장비 공급 확대

Semiconductor

반도체 · Adv. Packaging · 고부가 신시장 진입

Market AI · HBM 투자 확대 · 유리기판 상용화 · 첨단 패키징

Key Equipment Metal Sputter · TGV Laser · PlasmaLine

Growth Focus 유리기판 · 패키징 장비 사업화 · 고부가 시장 진입

MLCC

MLCC · 고사양 제품 · 핵심 공정 장비 확대

Market 전장 · AI 서버 수요 확대 · 고사양 MLCC 수요 증가

Key Equipment Stacking · Coating · Printing · Dipping

Growth Focus 핵심 공정 장비 공급 확대 · 고객 기반 다변화

03 핵심 기술 기반의 사업 다각화

핵심 기술 기반으로 첨단 산업에 필요한 핵심 장비를 공급하는 기술 혁신 기업, AVACO

핵심 기술



진공박막 증착기술

특허 등록

스퍼터 (국내 14건, 국외 15건)
OLED 진공물류 (국내 3건, 국외 3건)



고밀도 압연 기술

특허 출원

롤프레스 (국내 1건)
슬리터 (국내 6건)

FPD(Flat Panel Display) 제조용 진공장비, 전용장비, 자동화장비 기반 기술 확보

OLED, 이차전지, 소재, 반도체 등 첨단산업 중심



LCD Sputter
국내최초
LCD TFT Sputter (G7) 개발
2006

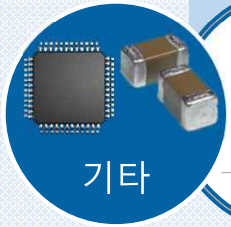
Low Damage Sputter
차세대 전극용 저손상 증착 기술 개발
2017

OLED
10.5세대 OLED 진공 증착 및 물류 시스템 개발
2018



자동화장비
자동화 시스템 개발
2020

Roll to Roll
텐덤 롤프레스, 테이핑기, 슬리터, 코터 등 이차전지 공정장비 개발
2023



MLCC
생산 장비 개발
2018

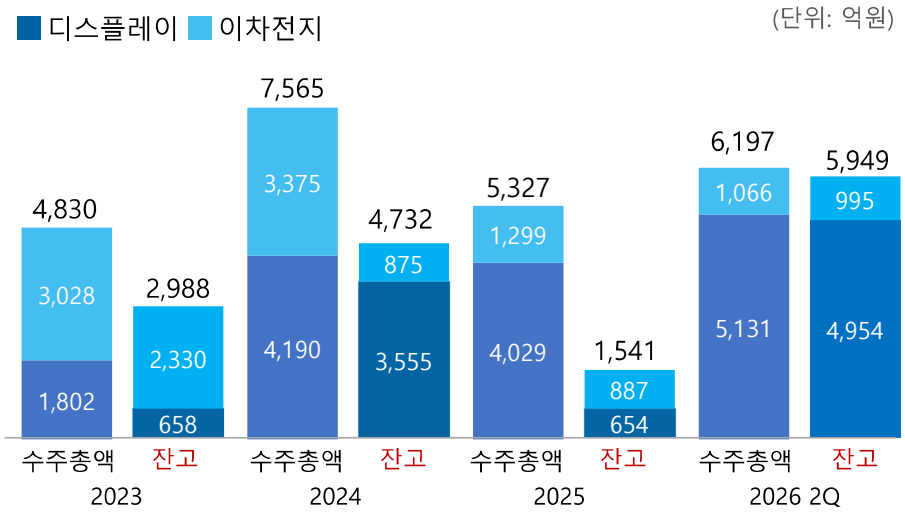
Plasma Line
PCB 건식공정 장비 개발
2020

3D Printer
생산 장비 개발
2021

반도체 Metal Sputter
반도체 패키지용 Metal Sputter 개발
2023

04 경영성과 Review

연수주액 및 수주잔고



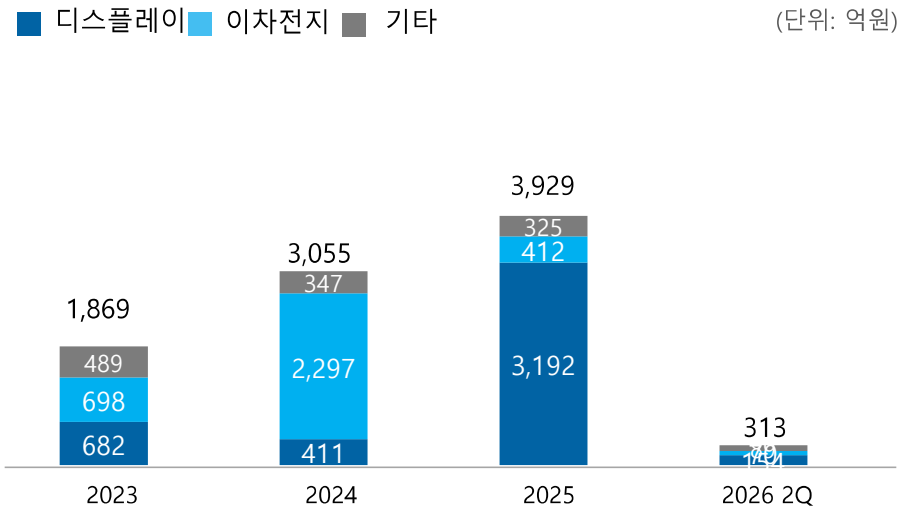
디스플레이

- 국내/해외 고객사 증설 투자에 따른 디스플레이 증착/모듈/물류 장비 신규 수주 기대감 지속
- B사 Phase 2 수주 반영으로 디스플레이 수주잔고 확대
- 중국 C사 수주 및 주요 고객사 후속 투자 대응 지속

이차전지

- EV 신규 증설 투자는 신중한 기조가 지속되는 가운데 ESS·LFP 중심의 투자 수요 확대될 것으로 예상
- ESS, 각형 LPF 등으로 고객사의 라인 전환에 따른 신규 장비 수요에 적극 대응 중(슬리터)

매출액 추이



디스플레이

- 주요 프로젝트 납기 및 매출 인식 시점이 이후 하반기 반영 예정
- 추가 수주를 위한 주요 고객사 대상 영업 활동 지속

이차전지

- 25년 이차전지 부문 매출은 감소
- 기존 납품 경험과 라인 대응 역량을 기반으로 후속 수주 기회 확보 추진

기타 장비

- Metal Sputter 국내 OSAT업체와 양산 평가 진행 중이며 유리기판 관련 장비 개발 완료 및 샘플테스트 등을 통한 활발한 영업 활동 중 → 매출 다각화 추진

출처: 사업보고서

05 글로벌 고객사 및 네트워크 확보

25년동안 글로벌 Top-tier 고객사 레퍼런스와 각 분야 전문가 네트워크 확보로 성장 동력 확보



25년말 기준 누적 **1,406** System 공급 실적 보유
(해외 : 691 Systems)

국내 및 해외 **250건** 이상 특허 보유 (출원/등록 포함)
연구개발 **44건** 보유 (디스플레이 28건, 태양광 9건, 반도체 및 기타 7건)



주요 고객사

AVACO

네트워크

LG Chem
LG Energy Solution
LG Display
LG Electronics
HKC
BOE
AVERY DENNISON
VELO 3D
코오롱인더스트리
华星光电 CSOT
HYOSUNG CHEMICAL
GVO 国显光电
TIANMA
ultium cells
posco
OVIS
MiaSolé
DOOSAN
희성전자
한화솔루션
SERVEONE 서브원
ILJIN 일진머티리얼즈
OS ADVANCED MATERIALS
Visionox

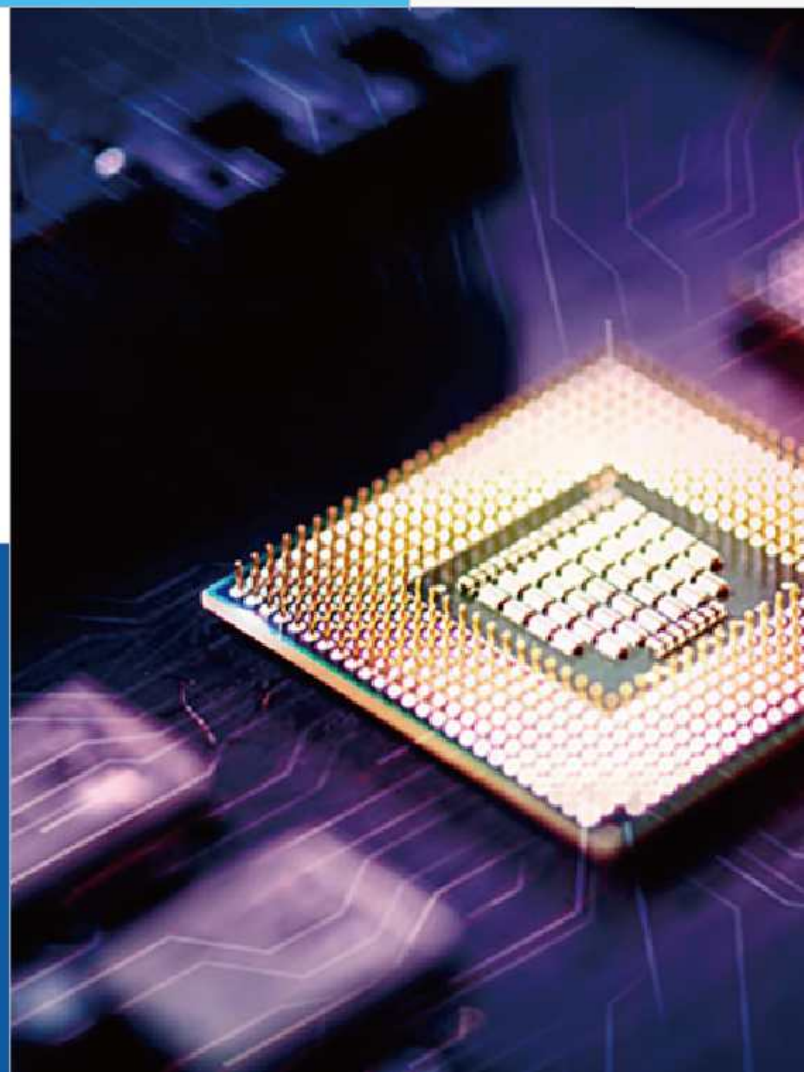
ETRI 한국전자통신연구원 Electronics and Telecommunications Research Institute
KFE 한국핵융합에너지연구원 KOREA INSTITUTE OF FUSION ENERGY
KIER 한국에너지기술연구원 KOREA INSTITUTE OF ENERGY RESEARCH
KAERI 한국원자력연구원 Korea Atomic Energy Research Institute
KSIA 한국반도체산업협회 KOREA SEMICONDUCTOR INDUSTRY ASSOCIATION
대구테크노파크 DAEGU TECHNOPARK
대구테크노파크 나노융합실용화센터 Nano Convergence Practical Application Center
KDIA Korea Display Industry Association
DGIST 대구경북과학기술원 Daegu Gyeongbuk Institute of Science & Technology
KOPIA 한국태양광산업협회
Yu Yeungnam University
대구가톨릭대학교 CATHOLIC UNIVERSITY OF DAEGU
군산대학교 KUNSAN NATIONAL UNIVERSITY
KAIST
연세대학교 YONSEI UNIVERSITY
KNU 경북대학교

Chapter 02

Core Technology



Advanced VAcuum &
Clean equipment Optimizer



01 디스플레이 (1) 다양한 디스플레이 장비 라인업 보유

26년 업력 기반 핵심 기술·장비 보유

OLED 디스플레이 핵심 장비



국내 최초 장비 개발

Sputtering System (스퍼터)

디스플레이 기판에 산화물 및 금속 물질을 증착하여 박막 형성 (디스플레이 제조용 진공 증착 시스템)
6세대/8세대/10.5세대



Vacuum Oven System

OLED증착 전 TFT Back panel을 진공에서 out-gassing하는 장비

Max 10.5세대



글로벌기업 수주

국내 유일 8.6세대 양산 가능

OLED In-line Vacuum System

OLED 증착 공정 중 마스크 및 기판을 연속적으로 운송 (OLED In-line Vacuum System)
6세대/8.6세대



OLED TFE System

패널증착이후 진공에서 OLED 손상없이 TFE(Thin Filem Encapsulation)공정을 진행하기 위한 챔버 등으로 이루어진 System

글로벌 고객사 레퍼런스 보유
기술 초격차 기반 시장 지위 선점

해외 유망 기술 보유 기업과 전략적 제휴
경쟁력 제고를 위해 연구개발 및 사업화

포트폴리오 확장
차세대 디스플레이 공정 장비로 확장

01 디스플레이 (2) 글로벌 디스플레이 고객사와 안정적 사업 영위

주요 디스플레이 장비 공급사로 고객사와 오랜 신뢰관계 구축

Sputter 최초 국산화

Sputter(스퍼터) 누적 수주 금액



OLED In-line Vacuum System 공급 확대

중국 글로벌 디스플레이 기업 B社

2026년중 양산 착수를 목표로 8.6세대 IT용 OLED Line 투자, 투자 완료시 월 3만 2,000장 생산 가능



OLED In-line Vacuum System

- OLED 증착 과정 중 불순물이 없는 진공상태에서 기판 검사 등의 공정을 수행하는 장비
- 8.6세대 OLED 라인 구축에 필수

2024년 1차 장비 수주 → 2024년 말 ~2025년 1차 장비 반입 → 2026년 2차 후속 수주

32K 물량 장비 수주 완료 16K 물량 장비 공급 완료	**국내 유일** OLED In-line Vacuum System 검증 완료	창사 이래 디스플레이 사업 사상 단일 규모 **최대 실적**

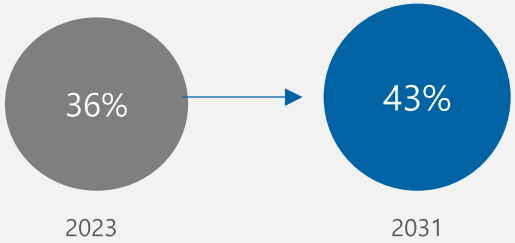
01 디스플레이 (3) OLED 투자 확대에 따른 장비 공급 기회 확대

글로벌 디스플레이 기업 향 OLED 장비 공급

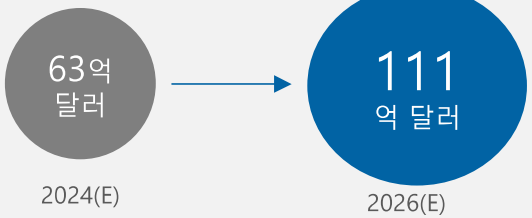
글로벌 OLED 투자 추이

BOE	TCL CSOT	LG디스플레이
8.6세대 IT OLED 분야에 2027년까지 약 11조원 투자	8.6세대 IT OLED 투자 계획 발표	27년까지 OLED에 1.2조원 투자 발표
총 32K/월 투자 계획 중 16K/월생산라인 장비 공급 중 잔여 16K/월 라인에 대한 후속 장비 수주 확보	잉크젯프린팅 기반 방식으로 라인 투자 예정 22.5K/월 규모 라인 구축을 위해 약 6조원 투자 예정으로 발표	OLED 생산라인용 장비 수주 확보 개별 장비 공급을 통해 후속 장비 수주 확보 예상

OLED 패널 점유율 전망[2)]



세계 디스플레이 설비투자 예상 추이[1)]



1), 2) 시장분석기관, OMDIA

01 디스플레이 (4) Low Damage Sputter : 차세대 전극 공정 대응 기술

박막 손상은 줄이고, 전극층은 균일하게 — 차세대 소자 공정의 핵심 기술

기술 개념

- 민감한 박막 손상을 줄이는
- **저손상 Sputter 증착 기술**
- 전극층을 얇고 균일하게 형성

왜 필요한가

- OLED·태양전지는 얇고 민감한
- 박막 위에 전극층을 형성
- **손상 최소화 = 성능·수율 확보**

아바코 대응 기술

- **낮은 충격의 균일 증착**
- 박막 표면 품질 개선
- 공정 안정성 향상
- 민감 박막 공정 대응

적용 가능 분야

차세대 OLED 전극 공정

투명전극층 형성 공정

페로브스카이트 태양전지 전극

고효율 에너지 소자 박막

Growth Point

디스플레이 Sputter 기술 → OLED · 투명전극 · 태양전지

차세대 전극 공정 시장으로 적용 영역 확대

02 이차전지 (1) 북미 수주 성과를 기반으로 주요 이차전지 장비업체로 자리매김

이차전지 Roll-to-Roll 및 자동화 시스템 수주 실적 확보

전극공정 → 조립공정 → 활성화 → 검사

전극공정: 믹싱 → 코팅 → 압연 → 슬리팅

Roll-to-Roll 설비



- 전극공정 연속 생산의 핵심 설비
- 코팅 공정에 필요 롤 개수 최대
- 일본 및 유럽 장비 점유율 高
- 국내 소수 업체 생산 중 (기술 진입장벽 高)

자동화 시스템



- 이차전지 산업 외 다방면 적용 가능
- LG에너지솔루션 북미 지역 3,645억원 규모 수주

Our Strength

노하우 보유
디스플레이 물류 및 공정 장비 경험으로 우수 품질 장비 개발 가능

CAPA 확대 완료
상주 제 6공장 완공 및 가동 준비 완료
→ 약 6천억원 규모 장비 생산 가능

글로벌 기업과의 네트워크
글로벌 기업 협력을 통해 제품 개발 및 Top-tier 매출처 보유

※ 출처 : Recycling of Lithum-Ion Batteries, Sergej Rothemel

02 이차전지 (2) 핵심 장비

전극 Roll Press (Single Type)		전극 Roll Press (Tandem Type)		Slitter (슬리터)		전극용 테이핑기	
							
기능	• 활물질이 도포된 전극 기재를 일정한 두께로 압연	**기능**	• 활물질이 도포된 전극 기재를 일정한 두께로 압연	**기능**	• 전극 폭을 규격에 맞게 절단	**기능**	• 양극 극판의 무지부 접힘을 방지하여 활물질 탈락 방지 및 안전성을 유지하는 시스템
특징	• 무인/자동화 • 고점도 양극 및 다층 극판 프레싱 • 압연 롤 제작 • 압연 두께 편차 및 밀도 구현 • 극판 무지부 주름 제거	**특징**	• 고정/조절 IP Digital Alignment • 전극 파단 예지 및 감지 시스템 • Press roll Bearing Housing 온도 및 진동 감지 시스템 • 무지부 Press 고도화 • Main Roll 온도 균일화 • 전극을 연속 2번 압연 → 高 생산성 및 압연율 구현 (두께 감소 및 밀도 향상) • 스프링백(Spring back) 현상[1] 방지	**특징**	• 자동 칼날 위치 가능 • Rewind Gap 및 터치모드 제어 • 고기능성 필름을 위한 저장력 제어 • 개별 클리닝 롤 설치 가능	**특징**	• Center 보정 Taper Roll 구성 • Tape End 감지장치 • Tape부착위치결정/정전기 제거 • 이물질 방지용 STS 재질의 Cover 설치

1) 스프링백 현상 : 변형에 저항하며 원래대로 돌아가려는 현상

02 이차전지 (3) 롤프레스 적용 코어 기술로 진입장벽 구축

高진입장벽 및 핵심 기술 완비로 롤프레스 기반 외연 확장



롤프레스 장비

기능 이차전지 공정에서 활물질이 도포된 전극(양극·음극) 기재를 압연해 일정한 두께(마이크로 단위)로 압연

특징 양극재, 음극재를 도포하는 전극코터(코팅장비)와 함께 이차전지 공정에 있어 핵심 장비로 분류, 기술 난이도 高

→ 국내 소수 업체 생산 중 : 기술 진입장벽 高

핵심기술	**고정/조절 IP Digital Alignment**	• 고정 및 조절 IP에 대한 Digital Leveler 및 Laser 거리 측정을 통한 신뢰성 확보 • Digital을 이용한 Setting 기준 확보 및 이상 정렬 모니터링
	전극 파단 예지 및 감지 시스템	• 전극 파단의 전조 증상을 감지하여 파단 전에 설비 정지 및 조치 가능
	Press roll Bearing Housing 온도 및 진동 감지 시스템	• 압연롤 정밀도에 중요한 요소인 Bearing 열발생에 의한 팽창을 모니터링 • Bearing Housing의 온도 및 진동 모니터링을 통한 정상 작동상태 지속 확인
	무지부 Press 고도화	• 안정적인 Tap pressing을 통한 단선 예방 • Digital gauge를 통한 표준화 Setting 및 위치 모니터링을 통한 신뢰성 확보
	Main Roll 온도 균일화	• 프레스 롤에 대한 TD 방향 온도 압연 시 ±1℃ 구현을 통한 압연 품질 향상

02 이차전지 (4) 차세대 공정장비 개발

차세대 高효율 공정장비 개발로 경쟁력 강화 및 매출 다각화

건식전극공정 장비



기술 난이도 高 + 원가절감 + 생산성 향상

리튬메탈음극공정 장비

단계	리튬이온 배터리	리튬메탈 배터리
음극 준비	흑연 슬러리 코팅 및 건조	리튬 증착 및 압착
전해질 충전	액체 전해질 주입	고체 전해질 도포 또는 특수 전해질
셀 조립	층상[1] 조립 (laminate stacking) 또는 권취[2] (winding)	박막 셀 조립 또는 고체 상태 조립
포메이션 충전	표준 충전	덴드라이트[3] 억제를 위한 특수 충전 프로토콜

에너지 밀도 10배 이상 증가 + 배터리 충전 속도 우위 + 배터리 방전율 감소 및 수명 연장

1) 층상 구조: 산소로 만들어진 팔면체 구성 층들이 규칙적으로 쌓여있는 구조
2) 권취: 배터리의 여러 층을 말아 감아서 하나의 셀로 만드는 과정
3) 덴드라이트: 리튬이온배터리 충전 시 음극 표면에 나뭇가지 형태로 쌓이는 리튬 결정체

03 신성장동력 (1) PlasmaLine : 첨단 패키징 건식 공정 장비

해외 파트너십 기반 PCB / 유리기판 공정장비 글로벌 진출 확대

PlasmaLine 장비

에칭과 증착을 연속 수행 가능

세계 최초 개발 완료



기능	• PCB 및 Glass 기판에 박막을 코팅하기 위해 애칭과 증착을 연속 수행하는 건식 공정장비
특징	• 고성능 전자제품 산업에 적용 가능 • 고밀도 다층 기판 및 IC 기판 제품 개발에 용이 • 플라즈마를 활용한 에칭/Desmear/전극(Cu)층 형성 • PCB 공정에서 Glass 기판 패키징 공정으로 확장

슈미드아바 코코리아 JV 설립 (2018)

- 170년 업력의 독일 생산장비기업
- 자동차, 의약, 식품, 반도체 및 IT 등 다양한 산업분야 진출
- PCB분야 핵심 기술 보유

- 아바코의 장비 제작 기술 + 슈미드 그룹 영업력 및 PCB분야 노하우 시너지
- PCB 공정기술 확보 및 양산화를 통한 글로벌 진출

장비 개발 및 판매

2020

PCB 건식공정 및 플라즈마를 활용한 EDR 장비 개발

중국, 대만, 유럽

PCB 제조업체 납품 완료 (N社, D社)

고도화 및 사업 확장

- 고객사와 양산화를 위한 초기 성능 검증 완료 → 양산 대응 중
- PCB 및 Glass 기판에 미세 선폭 패턴 가공 가능 → AI반도체 /고성능전자제품 시장 공략

2026(E)

국내외 업체들과 양산테스트 및 R&D용 장비 수주

1) Desmear:PCB제조 공정에서 드릴링 후 잔여 레진(Smear)을 제거하는 과정. 보통 화학물질로 제거하나 HDI, 반도체 기판 등은 플라즈마 방식 사용

03 신성장동력 (2) TGV Solution : 유리기판 공정 대응 확대

AI 반도체 시대, Glass 기판으로 — 차세대 패키징 시장 진입 확대

시장 방향

AI 반도체 · 고성능 패키징
수요 확대

→

Glass 기판 기반
공정 기술 주목

→

차세대 반도체
패키징 시장 확대

아바코 대응 영역

- **TGV Laser 기반 Glass 기판 가공 기술 확보**
- Glass 기판 공정 장비 시장 대응
- 디스플레이 공정의 진공·박막 기술 기반 확장

핵심 경쟁력

- **Glass 기판 미세가공 기술**
- 대면적 기판 대응 기반
- 정밀 가공 기반의 공정 신뢰성
- 차세대 패키징 장비 포트폴리오 강화

Growth Point

차세대 반도체 패키징 시장 진입 확대
Glass 기판 공정 장비 사업 확장 · 첨단 패키징 고부가 시장 대응

03 신성장동력 (2) TGV Laser System : 유리기판 미세홀 가공 핵심 장비











기능	• 반도체 패키징용 유리 기판에 미세한 홀을 정밀하게 가공하는 레이저 시스템 • 베젤광학계를 사용하여 균일하고 긴 초점 영역을형성하여 가공
특징	• 미세 크랙을 억제한 레이저 유리 개질 기술 • 고종횡비 홀 형성을 위한 정밀 가공 기술 • Dual Optical Heads 적용으로 2배 이상 패터닝 속도 구현 • 다양한 유리 소재 대응 가능

"다양한 고성능 기판 (유리, FC-BGA, ABF Substrate) 적용 가능"

"플라즈마 에칭을 사용하여 미세회로(0.5μm 이하) 구성 가능"

03 신성장동력 (2) PlasmaLine & TGV : 유리기판으로 응용처 확장



Turn-key로 유리기판 공정 장비 글로벌 고객사향 영업 계획

유리기판 가공부터 증착·식각까지 공정장비 포트폴리오 확대

1) TGV: Through Via Hole
2) ABF: Ajinomoto Build-up Film
3) DSM : Direct Surface Metallization

03 신성장동력 (3) 반도체 : 핵심 장비

Metal Sputtering System



기능	• 반도체용 박막 특성을 제어하여 다목적 초순도 금속 박막을 제조 (300mm wafer) • HBM등 AVP용 WLP(Wafer Level Package)공정 및 Fab공정에서 금속 박막 증착
특징	• 높은 신뢰성과 비용적인 측면에서 이점 제공 • 고객 요구사항에 따른 장비 구성 가능 • EFEM 기반의 자동화 공정이 적용으로 높은 생산성 구현

Metal Sputtering System



기능	• 반도체용 박막 특성을 제어하여 다목적 초순도 금속 박막을 제조 (200mm wafer)
특징	• 기존 공정 방식인 VCE(Vacuum Cassette Elevator)으로 처리 • 특수 공정 혹은 소량 생산에 적합

3D Inspection System

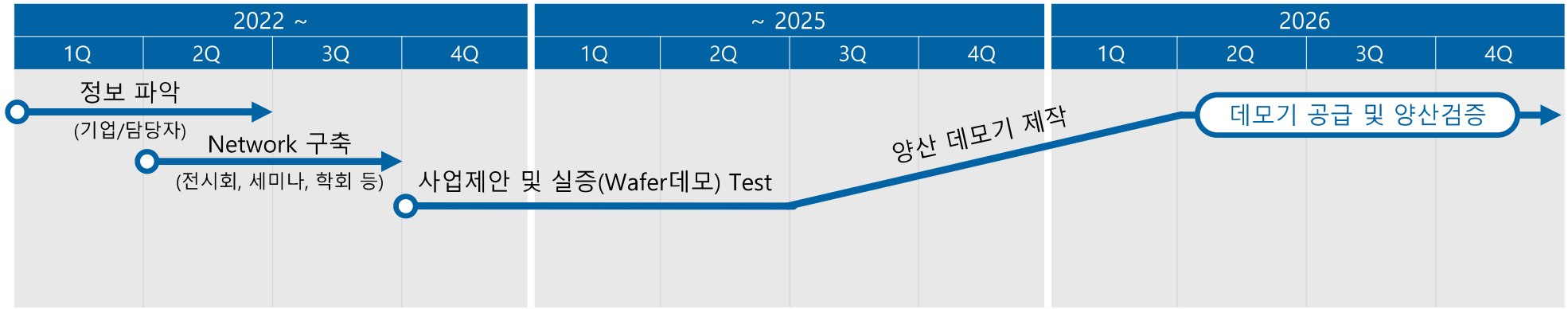


기능	• Wafer 검사 및 리뷰 시스템을 통해 Wafer의 높이 및 위상 정보를 측정
특징	• 3D 검사 방식으로 정확한 측정 및 분석 • nm 수준의 형상 검출 가능

03 신성장동력 (3) 반도체 : 대외 인프라 구축을 통한 고부가가치 산업 진출

증착 및 검사 장비 마케팅을 통한 반도체 산업 진출

개발 및 사업화 추진 전략



마케팅 타겟 기업

IDM & Foundry

SK hynix
삼성전자
DB HiTek
MagnaChip

OSAT & Others

LB Semicon
Amkor Technology
nepes
ASE Korea
SFA 반도체
STATSChipPAC
HANA MICRON
삼성전기
onsemi
Signetics

단계별 추진 전략



01	반도체 시장/기술 조사(경쟁사, 제조사 등)
02	반도체 제조사와 Sample/Wafer 데모
03	양산라인 데모 평가 및 검증(사양 및 신뢰성)
04	양산 검증 기반 상용화 구축

"우수한 장비 경쟁력 및 전략으로 고부가가치 반도체 산업 진출"

03 신성장동력 (4) MLCC : 주요 공정 장비 개발 완료

前공정 | 後공정, 검사/포장

믹싱 ▶ ① 코팅 ▶ 인쇄 ▶ ② 적층 ▶ 압착 ▶ 절단 ▶ 열처리 ▶ 연마 ▶ ③ 전극 ▶ ③ 도금 ▶ ④ ⑤ 측정 및 테이핑

① Coating System(코팅기), Printing System(인쇄기)

- 내부 전극을 고속 및 연속으로 인쇄하고 열풍 건조시키는 Coating System과 그라비어 유닛을 합성한 형태의 인쇄 시스템



② Stacking System (적층기)

- 세라믹 시트를 박리하고 高 전기적 특성을 유지, 정렬 위치를 보정하여 적층

MLCC 제조 핵심 장비



③ Dipping System (도포기)

- 칩 측면에 구리 외부 전극을 적용



④ N.G Chip Removing System

- 초음파 검사 이미지를 활용해 불량 칩 자동으로 선별



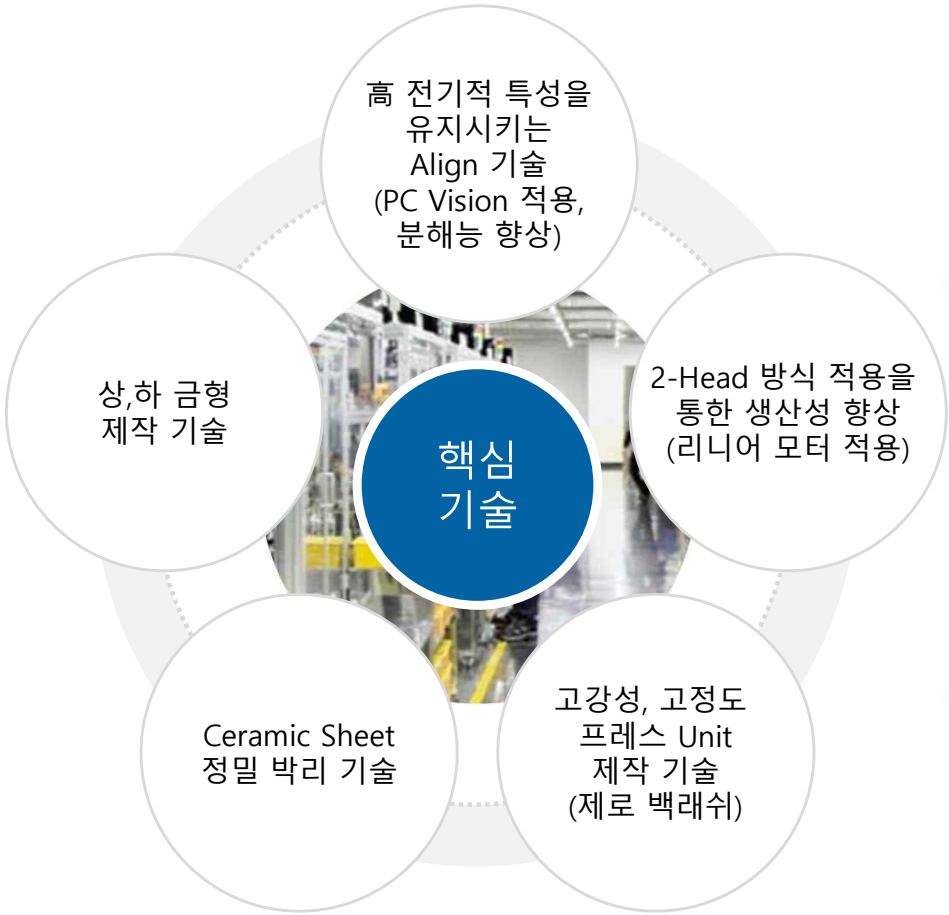
⑤ Arranging System

- 초음파 검사를 위해 MLCC 적층 방향을 자동으로 정렬하는 시스템



03 신성장동력 (4) MLCC : 계열사와의 시너지

핵심 기술 기반 장비 고도화 → 계열사 신산업 진출 시 적용 가능한 포트폴리오 구축



장비고도화

향후 전략

AJATEC Advanced VAcuum TEChnology

박막 코팅 및 MLCC 생산 Total Solution

- FPD의 ARAS를 위한 Coating Service
- LCD / OLED Glass Slimming (식각)
- MLCC 생산

MLCC 생산라인 3개 증설 계획

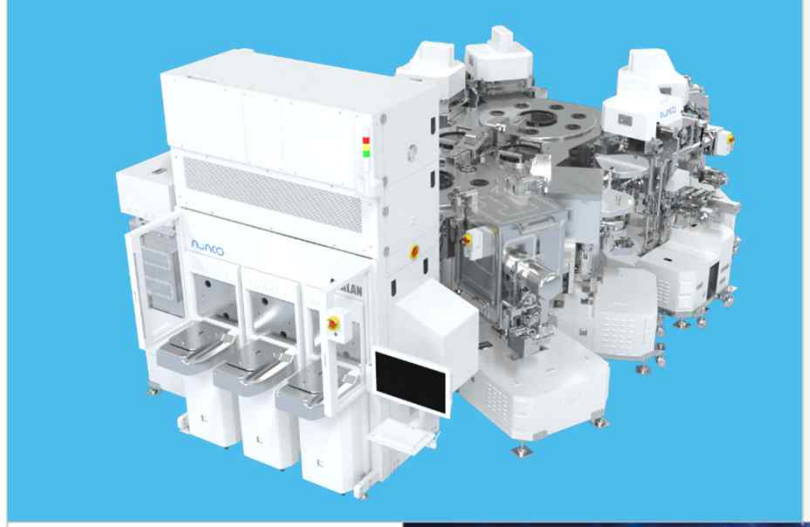
태양광 및 전장용 생산라인 구성 예정

- 총 CAPEX 900억원 (2027년 6월말까지 집행 공시)

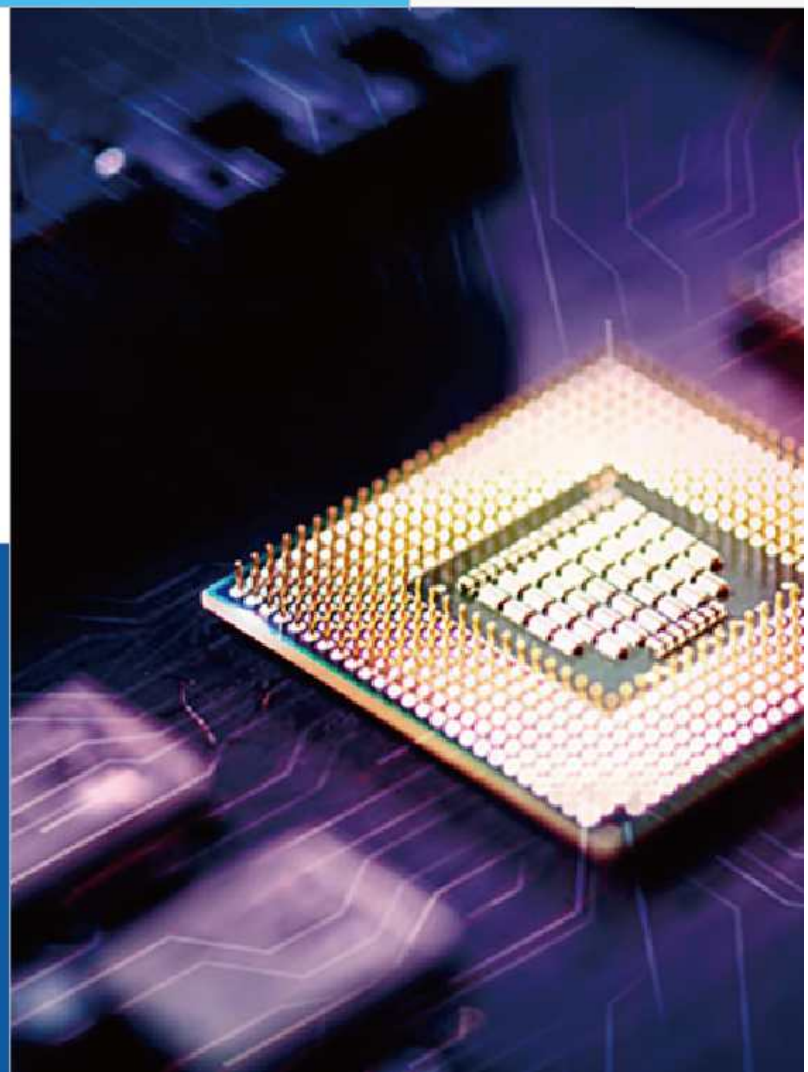


- 계열사 아바텍의 증설시 적층기 등 공급 예정 (총 소요 capex의 60% 이상 수주 예상)
- 중국 MLCC 제조사 'S'사에 하이엔드 MLCC 적층기 등 공급 예정

"아바텍의 전장용 MLCC 사업 진출시 수혜 기대"



Advanced VAcuum &
Clean equipment Optimizer



Chapter 03

Financial Highlights

01 실적 현황

연결기준

(단위 : 백만원)

구 분	2023	2024	2025	2025.2Q	YoY	2026.2Q
매 출 액	186,852	305,515	392,896	185,129	-83.1%	31,325
① 디스플레이 제조장비	68,247	41,122	319,249	147,289	-89.6%	15,358
② 이차전지 제조장비	69,779	229,693	41,150	24,505	-71.3%	7,045
③ 3D PRINTER	30,301	852	-	-	N/A	-
④ MLCC 제조장비	558	523	-	-	N/A	-
⑤ 기 타	17,967	33,325	32,497	13,335	-33.1%	8,921
매 출 원 가	156,435	249,700	327,564	148,468	-79.0%	31,155
매출총이익	30,417	55,815	65,333	36,661	-99.5%	169
판 관 비	26,009	35,417	30,715	20,638	-26.4%	15,199
영 업 이 익	4,408	20,398	34,618	16,022	N/A	(15,029)
(영업이익률)	2.4%	6.7%	8.8%	8.7%	N/A	-48.0%
당기순이익	4,257	23,890	28,650	5,676	N/A	(6,132)



매출액

- 디스플레이 매출인식 지연에 따라 전년 동일 분기 대비 2분기 매출 83% 감소
- (이차전지) 북미향 프로젝트 종료
  신규수주 부진 영향으로 매출 감소
- (디스플레이) 중국 고객사향 장비 매출 인식 이연

영업이익

- 매출 규모 감소에 따른 매출총이익 축소로 영업이익 적자

당기순이익

- 환율 변동에 따른 외화환산손실 감소 등 순손실 규모 축소

출처: 사업보고서

02 요약 재무제표(연결)

재무상태표

(단위 : 억 원)

구분	2023	2024	2025	2026 2Q
유동자산	2,522	2,784	1,572	2,140
비유동자산	927	1,027	1,663	1,938
자산총계	**3,449**	**3,811**	**3,235**	**4,078**
유동부채	1,553	1,764	956	2,000
비유동부채	54	60	61	70
부채총계	**1,608**	**1,824**	**1,017**	**2,070**
자본금	80	80	80	80
자본잉여금	573	572	446	325
기타자본 구성요소	(14)	(40)	(5)	(88)
이익잉여금	1,203	1,376	1,698	1,680
자본총계	**1,842**	**1,987**	**2,218**	**2,008**

포괄손익계산서

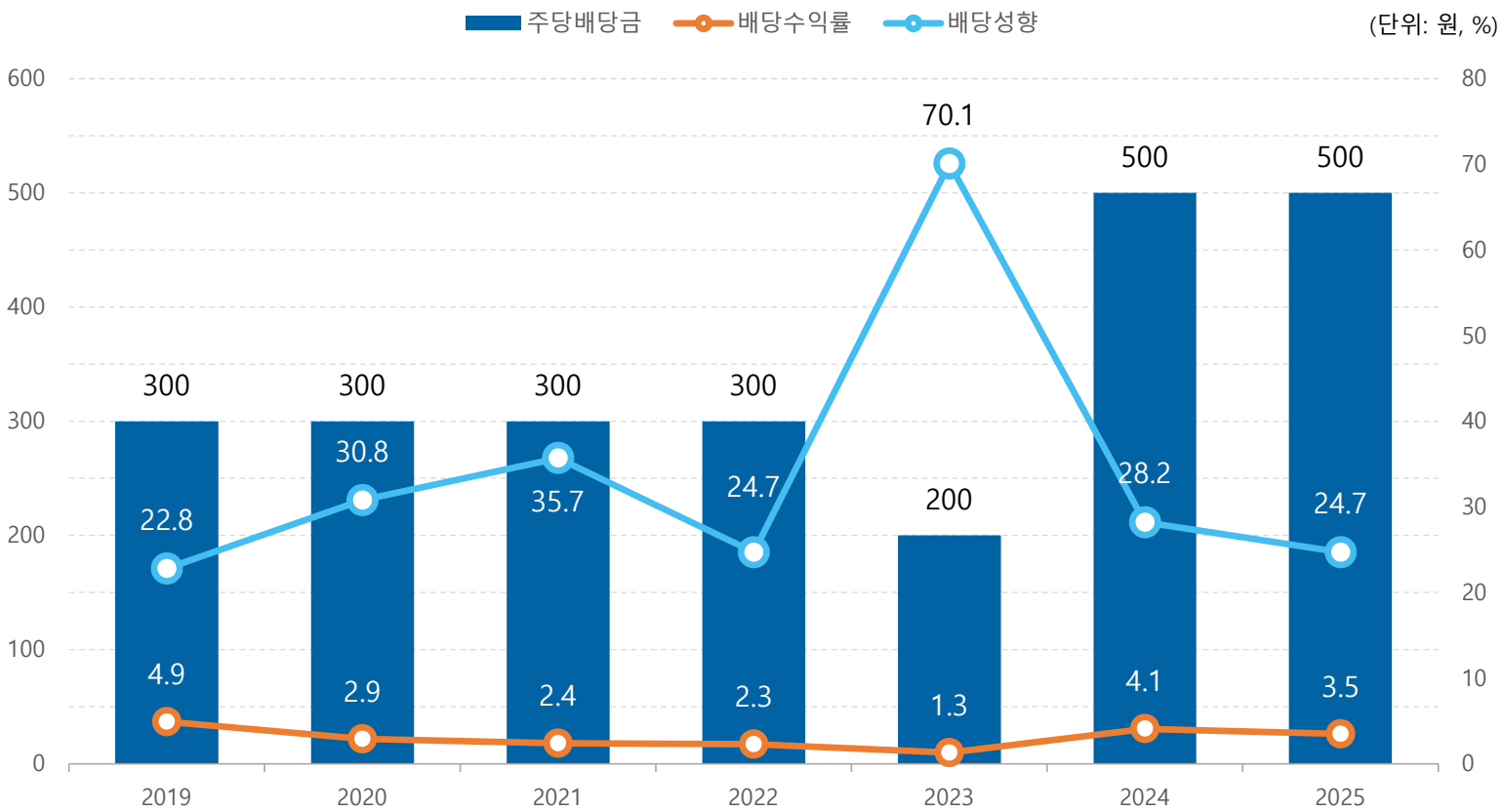
(단위 : 억 원)

구분	2023	2024	2025	2026 2Q
매출액	**1,869**	**3,055**	**3,929**	**313**
매출원가	1,564	2,497	3,276	312
매출총이익	304	558	653	2
판매비와 관리비	260	354	307	152
영업이익	**44**	**204**	**346**	**(150)**
금융수익	26	29	28	14
금융비용	32	49	28	4
기타수익	51	192	82	108
기타비용	33	79	97	21
세전계속 사업이익	55	298	347	(53)
법인세	13	59	60	8
당기순이익	**43**	**239**	**287**	**(61)**

03 주주친화 배당 정책(1)

주주환원 정책으로 지속 가능한 성장 도모





Comment

- 고배당 정책 지속 → 주주친화적 배당 정책 실현
- 2023년 실적 악화에도 불구, 배당 성향 확대를 통해 주주환원 의지 유지
- 2024년 이익 확대를 바탕으로 배당금 500원 지급
- 2025년 창사 이래 최대 매출을 재차 갱신하며 안정적인 고배당 기조 유지

03 주주친화 배당 정책(2)

주주 이익 극대화를 위한 감액 배당 재원 마련



감액배당과 일반 배당 비교

	감액배당	일반배당
배당 재원	자본준비금의 감액	순이익(이익잉여금) 활용
배당 원천	과거에 주주들로부터 받은 자본거래로 형성된 자금	기업이 영업활동을 통해 벌어들인 이익
배당 소득세	개인주주 : 비과세 법인주주 : 법인세 과세 이연 효과	배당소득세 15.4% 부과 금융소득종합과세 해당자 추가 과세
법적 규제	상법상 자본준비금과 이익잉여금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과해야 가능	별도의 법적제한 없음 (배당가능재원 있는 경우)

자본잉여금의 이익잉여금 전입 세부 내역

(단위: 벡만원)

2025년 결산 자본잉여금	금액	전입금액	전입 후 금액	비고
자본잉여금	44,502	12,000	32,502	-
주식발행초과금	26,781	12,000	14,781	자본금의 1.5배 적립 (상법 제461조의2)

Comment

- 2026년 3월 주주총회에서 자본잉여금의 이익잉여금 전입 안건 통과
- 2026년 결산 배당부터 적용 가능

Chapter 04

Company Overview



Advanced VAcuum &
Clean equipment Optimizer



01 회사 현황

회사 개요

법인명	주식회사 아바코
대표이사	김광현
설립일	2000년 01월 16일
임직원수	443명 (26.06월 기준)
자본금	80억원
본점 소재지	대구광역시 달서구 성서4차 첨단로 160-7(월암동)
홈페이지	www.avaco.co.kr
주요제품	· LCD 및 OLED 진공, 전용장비 · 이차전지 자동화 시스템 · 산업용소재 제조용 Roll-to-roll 장비 · MLCC 장비

CEO 프로필

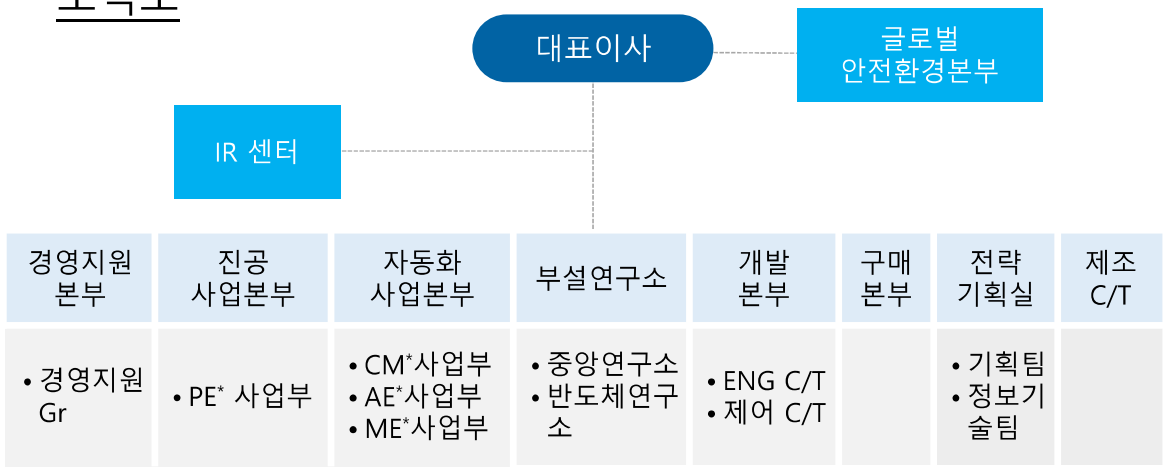


김 광 현 대표이사

경력 '15 ~ 現 ㈜아바코 대표이사
'10 ~ '15 ㈜아바코 부사장
'86 ~ '10 LG전자 디스플레이 사업부

학력 '84 영남대 기계공학과 졸업

조직도



* CM (Converting Machine), AE(Automation Equipment), PE(Process Equipment), ME (Module Equipment)

02 성장 연혁



설립 및 기반 구축
2000년 ~ 2007년

- **2000** ㈜AVACO 설립
- **2004** 대면적 Sputter 기술개발 사업자 선정 (산자부)
- **2005** - 성서 4차단지 제 2공장 건립
- KOSDAQ 상장
- **2006** 국내최초 LCD TFT Sputter (G7)개발
- **2007** 대구광역시 스타기업 선정



성장기
2008년 ~ 2014년

- **2008** 국내 최초 박막태양전지용 In-line Sputter (G5) 개발
- **2009** 구미 4차단지 제4공장 건립
- **2010** - 국내 최초 LCD CF/Sputter (G8) 개발
- AVACO Inc (USA) 미국법인 설립
- **2011** - NFRI(국가핵융합연구소)와 Sputter Plasma 3차원 시뮬레이션 기술이전 완료
- **2012** `2012 World-Class 300' 기업 선정(지식경제부)
- **2013** AVACO Machinery(Guangzhou) 중국법인 설립
- **2014** CIGS 박막태양전지 정부과제 완료(산자부)

도약기
2015년 ~

- **2015** - Miasole Hi-Tech 美 태양광 제조장비 공급
- NFRI, ETRI (한국 전자통신연구원)와 상호협력 협약 체결
- **2016** - 고밀도 플라즈마 증착 장비 정부과제 완료(산자부)
- 구미 4차단지 제5공장 건립
- **2017** - 투명 Flextible Display 정부과제 완료(산자부)
- 산업통산자원부 사업화 부문 장관상 수상
- **2018** - 동위원소 이차전지 정부과제 선정(산자부)
- 10.5세대 OLED 용 Sputter 및 물류 장비 개발
- 독일 Schmid와 기술 제휴 및 JV 설립
- PCB & PLP Substrate용 etcher & Sputter 개발
- **2019** - 반도체 FOWLP Metal Sputter 해외 기업과 전략적 제휴
- **2020** - 이차전지 및 PCB용 Roll-to-roll 장비 사업부 신설
- **2021** - 슈나이더일렉트릭코리아와 공동협력 MOU 체결
- '이달의 산업기술상' 수상 (산자부)
- **2022** 이차전지 Roll-to-roll 장비 개발완료
- **2023** 상주 신공장 건립(상주일반산업단지)
- **2024** BOE 우수협력사 수상
- **2026** 미국 Yesol Inc. 인수